

信用等级通知书

东方金诚债跟踪评字【2025】0140 号

常州银河世纪微电子股份有限公司：

东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及“银微转债”的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，同时维持“银微转债”信用等级为 A+。

东方金诚国际信用评估有限公司

信评委主任

二〇二五年六月十八日

信用评级报告声明

为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具的信用评级报告（以下简称“本报告”），本公司声明如下：

1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正的关联关系。

2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。

3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。

4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责，东方金诚按照相关性、可靠性、及时性的原则对评级信息进行合理审慎的核查分析，但不对资料提供方和/或发布方提供的信息合法性、真实性、准确性及完整性作任何形式的保证。

5.本报告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本报告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。

6.本报告自出具日起生效，在受评债项的存续期内有效。其中主体评级结果有效期自2025年6月18日至2026年6月17日有效，该有效期除终止评级外，不因任何原因调整。在评级结果有效期内，东方金诚有权作出跟踪评级、变更等级、撤销等级、中止评级、终止评级等决定，必要时予以公布。

7.本报告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。使用者必须按照东方金诚授权确定的方式使用并注明评级结果有效期限。东方金诚对本报告的未授权使用、超越授权使用和不当使用行为所造成的一切后果均不承担任何责任。

8.本声明为本报告不可分割的内容，委托方、受评对象等任何使用者使用/引用本报告，应转载本声明。

东方金诚国际信用评估有限公司

2025年6月18日

常州银河世纪微电子股份有限公司
主体及“银微转债”2025年度跟踪评级报告

主体信用跟踪评级结果	跟踪评级日期	上次评级结果	评级组长	小组成员
A+/稳定	2025/6/18	A+/稳定	宋馨	乔艳阳

债项信用			评级模型			
债项简称	跟踪评级结果	上次评级结果	一级指标	二级指标	权重（%）	得分
银微转债	A+	A+	企业规模	营业收入	15.00	6.81
			市场竞争力	产品竞争力	10.00	5.00
				技术及研发实力	10.00	5.00
				竞争壁垒	10.00	3.00
				成长性	5.00	4.00
盈利能力和运营效率			净利润	10.00	4.92	
			毛利率	10.00	7.15	
			总资产周转率	5.00	3.86	
债务负担与保障程度			资产负债率	15.00	12.60	
			经营现金流流动负债比	10.00	7.49	
调整因素					无	
个体信用状况					a+	
外部支持					无	
评级模型结果					A+	
注：最终评级结果由信评委参考评级模型输出结果通过投票评定，可能与评级模型输出结果存在差异。						

评级观点

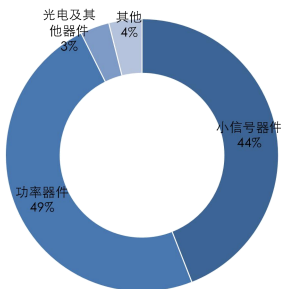
公司主要从事半导体分立器件研发、生产和销售，跟踪期内，公司围绕芯片设计迭代、新封装开发、产品质量改善、集成器件开发等进行研发，并持续推进新产品布局；2024年，下游市场温和复苏，公司积极调整产品结构、加大客户拓展力度，小信号器件、功率器件销量同比增长，带动营业收入及毛利润增长。

但同时，半导体分立器件领域技术更迭较快，下游客户需求不断升级、行业产品迭代仍将使公司面临技术升级挑战；2024年，应收账款及存货对资金占用增加，经营性现金流净流入规模有所下降；2024年末，公司在建项目后续投资规模仍较大，外部环境变化或将使公司面临投资回报不及预期的风险。

综合分析，东方金诚维持公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，维持“银微转债”的信用等级为A+。

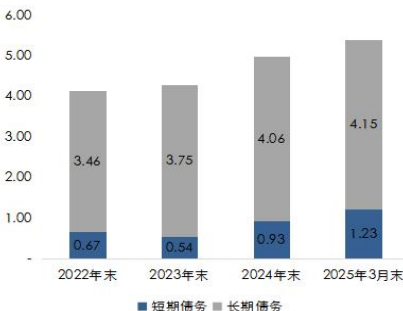
主要指标及依据

2024 年收入构成



类别	占比
功率器件	49%
小信号器件	44%
其他	4%
光电及其他器件	3%

债务结构 (单位: 亿元)



年份	短期债务	长期债务
2022年末	0.67	3.46
2023年末	0.54	3.75
2024年末	0.93	4.06
2025年3月末	1.23	4.15

主要数据和指标

项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 3 月
资产总额 (亿元)	19.04	19.90	22.06	22.08
所有者权益 (亿元)	12.84	13.21	13.65	13.70
全部债务 (亿元)	4.13	4.29	4.99	5.38
营业总收入 (亿元)	6.76	6.95	9.09	2.18
利润总额 (亿元)	0.96	0.69	0.75	0.06
经营性净现金流 (亿元)	1.06	1.02	0.67	0.04
营业利润率 (%)	27.88	25.80	25.62	23.61
资产负债率 (%)	32.57	33.60	38.10	37.92
流动比率 (%)	681.89	644.76	443.90	458.69
全部债务/EBITDA (倍)	2.62	2.76	2.90	-
EBITDA 利息倍数 (倍)	10.35	4.73	4.83	-

注: 数据来源于公司 2022 年~2024 年经审计的合并财务报告及 2025 年 1~3 月未经审计的合并财务报表。

- 优势
- 公司主要从事半导体分立器件研发、生产和销售, 具备多门类系列化器件设计、部分品种芯片制造、多工艺封装测试以及销售和服务的一体化经营能力, 跟踪期内仍具有一定细分市场竞争力;
 - 跟踪期内, 公司围绕芯片设计迭代、新封装开发、产品质量改善、集成器件开发等进行研发, 研发费用 0.56 亿元, 同比增加 33.08%, 获得发明专利 10 项, 有助于未来业务发展;
 - 跟踪期内, 公司持续推进新产品布局, 车规级半导体器件产业化项目进入产能爬坡阶段, 产品涵盖 IGBT、SiC MOSFET 等, 获得多家车企供应链认证, 同时光电耦合器及 LED 产品实现工业自动化、医疗设备等领域应用;
 - 2024 年, 下游市场温和复苏, 公司积极调整产品结构、加大客户拓展力度, 小信号器件、功率器件销量同比增长, 带动营业收入及毛利润增长。

- 关注
- 半导体分立器件领域技术更迭较快, 下游客户需求不断升级、行业产品迭代仍将使公司面临技术升级挑战;
 - 2024 年, 应收账款及存货对资金占用增加, 经营性现金流净流入规模有所下降;
 - 2024 年末, 公司在建项目后续投资规模仍较大, 外部环境变化或将使公司面临投资回报不及预期的风险。

评级展望

公司评级展望为稳定。未来, 随着国产替代的加速进行以及汽车电子、工业控制领域需求的增长, 预计公司仍将保持在小信号及功率器件领域较强的市场竞争力。

评级方法及模型

半导体企业信用评级方法及模型 (RTFC027202504)

主体信用等级	债项信用等级	评级时间	项目组	评级方法及模型	评级报告
A+/稳定	A+	2024/4/29	高君子、宋馨	《半导体企业信用评级方法及模型》(RTFC027202403)	阅读原文
A+/稳定	A+	2021/12/16	高君子、宋馨	《信息技术企业信用评级方法及模型》(RTFC012202004)	阅读原文

注: 自 2021 年 12 月 16 日 (首次评级) 以来, 银河微电主体信用等级未发生变化, 均为 A+/稳定。

本次跟踪相关债项情况

债项简称	上次评级日期	发行金额（亿元）	存续期	增信措施	增信方/主体信用等级/ 评级展望
银微转债	2024/4/29	5.00	2022.07.04~ 2028.07.03	无	无

跟踪评级原因

根据相关监管要求及常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“银河微电”或“公司”）相关债项的跟踪评级安排，东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）进行本次定期跟踪评级。

主体概况

跟踪期内，银河微电仍主要从事小信号器件、功率器件等半导体分立器件的生产、销售，截至 2025 年 3 月末，公司股本 1.29 亿股，控股股东仍为常州银河星源投资有限公司（以下简称“银河星源”），持股比例为 31.61%，实际控制人仍为自然人杨森茂。

公司主营半导体分立器件制造业务，产品包括小信号器件、功率器件等，掌握多个门类、多种封装外形产品的设计技术和制造工艺。公司在半导体分立器件封装测试领域拥有多年经验积累，并向上游器件设计、芯片制造等领域延伸，掌握高密度阵列式框架设计技术、芯片预焊技术等半导体分立器件封装测试通用技术，以及平面结构芯片无环高耐压终端技术、平面结构功率稳压二极管、TVS 芯片设计及制备技术等功率二极管芯片制造技术，截至 2024 年末，公司累计拥有有效专利 245 项，其中发明专利 41 项。同时，仍与比亚迪等客户保持合作，具有一定市场竞争力。

截至 2025 年 3 月末，公司资产总额 22.08 亿元，所有者权益 13.70 亿元，资产负债率为 37.92%。2024 年和 2025 年 1~3 月，公司分别实现营业收入 9.09 亿元和 2.18 亿元，分别实现利润总额 0.75 亿元和 0.06 亿元。

债券本息兑付及募集资金使用情况

“银微转债”募集资金总额 5.00 亿元，扣除发行费用后，募集资金净额 4.91 亿元，截至 2024 年末，已累计使用募集资金 1.90 亿元，其中 1.32 亿元用于“车规级半导体器件产业化项目”，0.58 亿元用于补充流动资金。

截至本报告出具日，“银微转债”按时支付利息，尚未到还本日。

截至 2025 年 3 月 31 日，“银微转债”累计共有 261000.00 元转为公司普通股，累计转股数量为 8167 股，占“银微转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0063%。

宏观经济和政策环境

一揽子增量政策效果持续显现，2025 年一季度 GDP 延续较快增长，二季度外部经贸环境变数骤然加大，可能给宏观经济运行带来较大冲击

2025 年一季度 GDP 同比增长 5.4%，增速与去年四季度持平，超出市场普遍预期。一季度内需全面发力，是推动经济实现“开门红”的主要动力。其中，受耐用消费品以旧换新政策扩

围加力提振，一季度商品消费增速持续加快；财政稳增长靠前发力，一季度基建投资提速，大规模设备更新继续推动制造业投资处于较高增长水平；与此同时，在楼市延续回稳、房企资金来源改善等带动下，一季度房地产投资降幅也略有收窄。一季度内需改善，贸易战影响还不明显，外需保持较强韧性，共同推动工业生产增速继续高于整体经济增长水平。

不过，一季度经济运行仍面临一些困难和挑战，主要是房地产市场止跌回稳基础尚不牢固，房地产投资仍有接近两位数的较大降幅，居民消费和民间投资信心总体偏弱，以及物价水平偏低等。往后看，外部经贸环境变数加大，二季度我国出口将出现较大幅度下滑，宏观经济运行面临较为明显的下行波动。

宏观政策将实施超常规逆周期调节，财政、货币和房地产支持政策有望全面加码

外部经贸环境变数加大，将加快国内宏观政策对冲步伐。综合考虑当前外部经贸环境变化、房地产市场走势及物价水平，二季度“择机降准降息”时机趋于成熟。这能有效激发企业和居民融资需求，扩投资促消费，提振市场信心，是当前对冲外部波动最有力的手段。财政政策方面，接下来促消费政策力度会进一步加大，政策节奏也将显著加快，以消化可能出现的“出口转内销”。除了 3000 亿元超长期特别国债资金支持耐用消费品以旧换新外，不排除各地将加大促消费支持范围，将更多普通消费品和服务消费纳入支持范围的可能。外部经贸环境急剧变化的背景下，稳楼市的迫切性显著上升。考虑到计入物价因素后，当前实际居民房贷利率仍处于较高水平，后期稳楼市政策空间充裕。总体上看，二季度宏观政策有望启动超常规逆周期调节。

行业分析

跟踪期内，公司营业收入仍主要来源于小信号器件、功率器件等半导体分立器件的生产、销售，属于半导体分立器件制造行业。

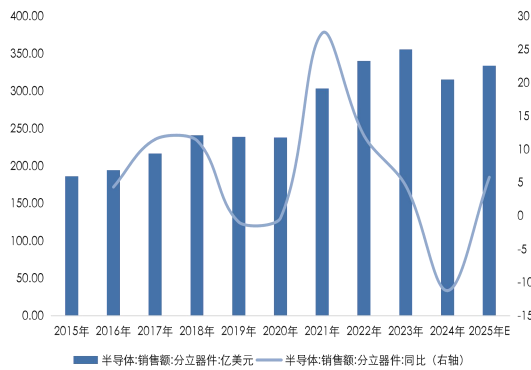
跟踪期内，经济周期和细分领域需求分化导致全球分立器件市场规模下滑，但随着新能源汽车、5G 通信、工业自动化等新兴领域的需求增长及国产化替代加速，国内市场的韧性显著

半导体分立器件是指具有单独功能且功能不能拆分的电子器件，主要功能为实现各类电子设备的整流、稳压、开关、混频、放大等，具有广泛的应用范围和不可替代性，是半导体产业的基础及核心领域之一。半导体分立器件产品包括小信号器件（小信号二极管、小信号三极管）和功率器件（功率二极管、功率三极管、桥式整流器）等，下游应用领域主要包括计算机及其周边设备、家用电器等传统领域及汽车电子、新能源发电和 5G 等新兴领域。

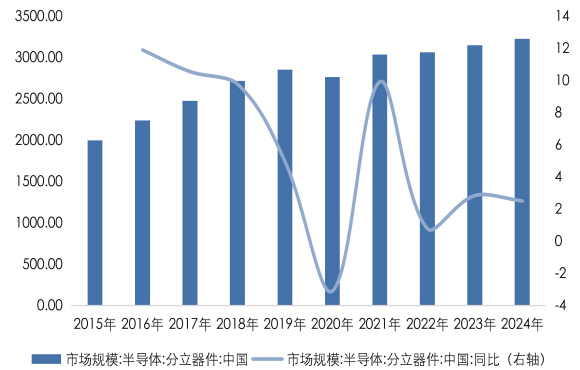
2024 年，全球半导体市场因经济周期和细分领域需求分化呈现波动，根据 WSTS 的数据，2024 年全球分立器件市场规模下滑至 315.46 亿美元。但中国市场的韧性显著，2024 年市场规模突破 3200 亿元¹，2030 年预计超 4300 亿元，核心驱动力包括新能源汽车、5G 通信、工业自动化等新兴领域的需求增长及国产化替代加速。预计 2025 年，中国市场仍保持较强的需求韧性。

¹ 统计口径包括光电器件、传感器等，与 WSTS 的统计口径存在差异。

图表 1：近年全球半导体分立器件销售额（亿美元、%）



图表 2：近年我国半导体分立器件产业销售额（亿元、%）

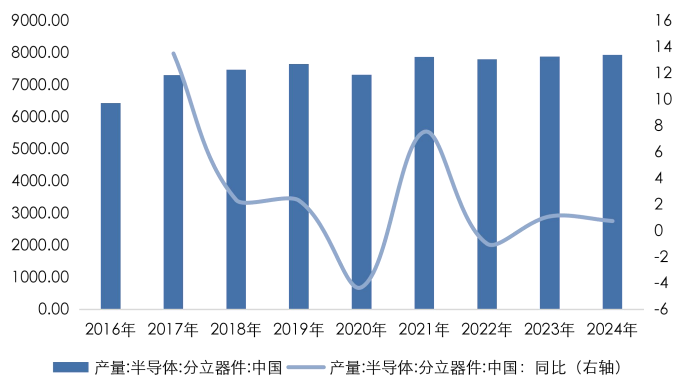


资料来源：世界半导体贸易统计组织、iFind、东方金诚整理

国际企业凭借技术优势在竞争中保持优势地位，国内企业在中低端领域逐步实现国产替代，近年产量有所增长，但由于市场分散，竞争较为激烈

从供给端来看，全球市场上，英飞凌、安森美、意法半导体等国际企业凭借在多规格中高端芯片制造技术和先进的封装技术方面的优势，占据了全球半导体分立器件的主要市场份额，在全球竞争中保持优势地位。国内市场上，分立器件市场较为分散且市场化程度较高，竞争较为激烈，属于充分竞争市场。国内企业如华润微、士兰微、扬杰科技、银河微电等通过技术突破和产能扩张，逐步在功率器件（如 MOSFET、IGBT）领域缩小与国际巨头（英飞凌、安森美等）的差距，但高端市场仍依赖进口。随着下游需求扩张和产业转移，叠加政策推动影响，近年我国半导体分立器件产量有所增长。

图表 3：近年我国半导体分立器件产量（亿只、%）



资料来源：iFind、东方金诚整理

国际贸易争端频发背景下，未来半导体产业的国产替代将持续加速进行，国家产业政策为半导体产业链的发展营造了良好的外部环境

近年来，国际贸易争端频发，半导体产品的进口替代被提升到国家战略的层面。《国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》提出，要加快发展现代产业体系，坚持自主可控、安全高效，加快补齐基础元器件的瓶颈短板。同时，随着国内终端厂商逐步将供应链转移至国内，上下游联动协同发展的驱动力将带动半导体产业的国产替代持续加速进行。

半导体分立器件行业作为信息技术产业的基础，近年来国家颁布了一系列政策法规对行业进行直接、间接支持，鼓励本土企业在拥有自主知识产权的基础上，与国际产品形成良性竞争，降低我国对进口半导体分立器件的依赖程度。2023 年，工业和信息化部、财政部提出《电子信息制造业 2023~2024 年稳增长行动方案》，指出要着力提升芯片供给能力，积极协调芯片企业与应用企业的对接交流。面向数字经济等发展需求，优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平，增强材料、设备及零配件等配套能力。国家半导体产业政策的技术导向和扶持对行业内企业经营形成了良好的发展环境，有利于较为完善的半导体行业产业链的形成。

业务运营

经营概况

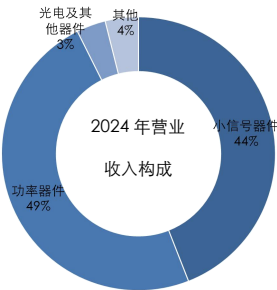
公司营业收入和毛利润仍主要来源于小信号器件、功率器件生产和销售，跟踪期内，营业收入、毛利润同比增长，综合毛利率变化不大

跟踪期内，公司仍主营小信号器件、功率器件等半导体分立器件的生产和销售，并涉及光电器件及其他器件等，小信号器件、功率器件销售收入合计占比仍在 90%以上，是公司主要收入和毛利润来源。2024 年，外部市场温和复苏，公司积极调整产品结构、加大客户拓展力度，带动公司营业收入、毛利润同比增长；由于不同产品价格有所分化，毛利率同比变化不大。

图表 4：公司营业收入构成及毛利润、毛利率情况（亿元、%）

类别	2022 年		2023 年		2024 年	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率	毛利润	毛利率
小信号器件	3.23	47.72	3.31	47.60	4.00	44.04
功率器件	3.06	45.24	3.17	45.60	4.42	48.59
光电及其他器件	0.28	4.21	0.27	3.94	0.31	3.45
其他	0.19	2.83	0.20	2.86	0.36	3.92
合计	6.76	100.00	6.95	100.00	9.09	100.00
小信号器件	1.12	34.61	1.05	31.66	1.23	30.76
功率器件	0.65	21.31	0.67	21.26	1.09	24.67
光电及其他器件	0.10	33.64	0.07	24.34	-0.02	-5.85
其他	0.05	27.93	0.05	26.63	0.08	22.67
合计	1.92	28.36	1.84	26.49	2.38	26.22

资料来源：公司提供，东方金诚整理



小信号及功率器件制造

公司主要从事半导体分立器件研发、生产和销售，具备多门类系列化器件设计、部分品种芯片制造、多工艺封装测试以及销售和服务的一体化经营能力，跟踪期内持续推进 IGBT、SiC MOSFET 等新产品布局，获得多家车企供应链认证，同时光电耦合器及 LED 产品实现工业自动

化、医疗设备等领域应用，仍具有一定细分市场竞争力

公司主要从事小信号、功率器件等半导体分立器件研发、生产和销售，小信号及功率器件产业链涉及器件设计、晶圆和芯片设计制造、封装测试三个主要环节。公司目前的产品涵盖小信号器件、功率器件、光电器件及其他电子器件，掌握了 20 多个门类、近 110 种封装外形产品的设计技术和制造工艺，能够量产上万个规格型号的分立器件，可以满足客户的一站式采购需求。同时，以封装测试专业技术为基础，逐步拓展部分功率二极管芯片的设计和制造能力、MOSFET 等芯片的设计能力，具备一定器件一体化设计及生产整合能力。同时，公司建有较强的营销团队和集客户要求识别、产品设计、应用服务、失效分析等为一体的技术服务团队，依托丰富的产品种类和专业化的技术支持，为客户提供一站式采购服务。在新产业布局方面，公司“车规级半导体器件产业化”项目进入产能爬坡阶段，产品涵盖 IGBT、SiC MOSFET 等，公司车规级产品的设计生产过程严格遵循 IATF16949 质量管理体系标准，性能和可靠性符合 AEC-Q101 车规试验验证，产品已广泛应用于车身控制、智能驾舱、车载照明、BMS 等领域，并与多家国内外汽车零部件头部企业建立了合作关系。同时，光电耦合器及 LED 产品已应用于工业自动化、医疗设备等领域，并与多家客户合作，开发高精度传感器及电源管理模块。整体来看，公司仍具有一定细分市场竞争力。

跟踪期内，公司围绕芯片设计迭代、新封装开发、产品质量改善、集成器件开发等进行研发，全年研发费用 0.56 亿元，同比增加 33.08%，获得发明专利 10 项，有助于未来业务发展，但半导体分立器件领域技术更迭较快，公司仍面临技术升级挑战

作为半导体分立器件制造商，跟踪期内，公司持续在半导体分立器件芯片制造、封装测试、产品应用等领域进行技术研发。截至 2024 年末，公司拥有研发人员 187 人，占公司总人数 15.39%，同比变动不大。2024 年，公司在超低阻抗高散热功率贴片封装及器件开发、面向平面芯片的精密封装技术及产品开发、高电流密度高性能功率整流芯片及产品开发等领域进行研发投入，全年研发费用 0.56 亿元，同比增加 33.08%，占营业收入的比例为 6.17%；取得从芯片设计及迭代（6 英寸平面芯片、HVIC 芯片、FRMOS、SGT MOS 等）到新封装开发（铝带工艺 PDFN3×3、TO-247-4L、sTOLL、DFN8×8 等）、从质量持续改善（过程能力提高、异常问题改善）到集成器件开发（达林顿阵列、半桥驱动 IC）等的成果实现，公司新增申请发明专利 15 个，获得 10 个，新增申请实用新型专利 31 个，获得 25 个，截至 2024 年末，公司累计拥有有效专利 245 项，其中发明专利 41 项，实用新型专利 200 个，掌握高密度阵列式框架设计技术、芯片预焊技术等半导体分立器件封装测试通用技术，以及平面结构芯片无环高耐压终端技术、平面结构功率稳压二极管、TVS 芯片设计及制备技术等功率二极管芯片制造技术，并形成了多个在研项目²。

但半导体分立器件领域技术更迭较快，近年沿着尺寸更小、功率密度更高的方向发展，在封测方面，第三、四代产品不断有新的封装出现，在多颗产品集成、功率增强等方面持续前进。目前在公司自主生产的产品中，封装形式主要集中在前三代，在高端市场的研发实力、工艺积

² 资料来源：公司《2024 年年报》。

累、产品设计与制造能力等方面与国际厂商相比仍存在技术差距。未来随着产品应用场景逐步拓展，下游客户对器件开关速度、工作电流、电压等的要求将越来越高，二极管、三极管产品的局部迭代不可避免，公司仍将面临技术升级挑战。

公司采用以销定产为主的生产模式，跟踪期内，由于部分产线投产，产能有所提升，“车规级半导体器件产业化”项目进入产能爬坡阶段，产量、产能利用率同比有所增长

公司生产主要由公司本部及子公司常州银河电器有限公司负责，均位于江苏省常州市。跟踪期内，公司采用“以销定产，柔性组织”的生产模式。2024年，由于部分新增产线投产，产能有所提升；产量方面，公司“车规级半导体器件产业化”项目进入产能爬坡阶段，2024年小信号器件及功率器件产量及产能利用率同比均有提升。

图表 5：近年公司小信号及功率器件生产情况（百万只、%）

		2022 年	2023 年	2024 年
小信号器件	产能	9339.37	9986.89	11420.66
	产量	6305.64	7089.83	9753.70
	产能利用率	67.52	70.99	85.41
功率器件	产能	5731.04	5822.83	6156.04
	产量	2915.11	3381.14	4397.31
	产能利用率	50.87	58.07	71.43

资料来源：公司提供、东方金诚整理

2024年，外部市场温和复苏，公司积极调整产品结构、加大客户拓展力度，带动小信号器件、功率器件销量及销售收入同比增长，预计 2025 年，随着新能源汽车、5G 通信等新兴领域的需求增长及国产化替代加速，公司小信号器件、功率器件需求空间仍较为广阔

2024年，外部市场温和复苏，公司适时优化内部产品结构，重点提升 MOS 产品、TVS 及稳压管产品的销售占比，推动产销量稳步增长，在车规级半导体器件产业化项目方面，客户拓展取得显著突破。销售价格方面，小信号器件销售均价有所下降，由于产品结构调整，功率器件销售均价同比提升。

受益于销量提升，小信号器件收入同比提升，但毛利率略有下滑；量价齐升带动功率器件销售收入、毛利率均同比增加。预计 2025 年，随着新能源汽车、5G 通信、工业自动化等新兴领域的需求增长及国产化替代加速，公司小信号器件、功率器件需求空间仍较为广阔，将带动公司产品销售规模增长。

图表 6：近年公司小信号及功率器件销售情况

		2022 年	2023 年	2024 年
小信号器件	销量（百万只）	6406.14	6925.60	9633.17
	销售均价（元/千个）	50.35	47.78	41.56
	销售收入（亿元）	3.23	3.31	4.00
	毛利率（%）	34.61	31.66	30.76
功率器件	销量（百万只）	2943.40	3370.04	4395.42
	销售均价（元/千个）	103.90	94.08	100.48

销售收入（亿元）	3.06	3.17	4.42
毛利率（%）	21.31	21.26	24.67

资料来源：公司提供、东方金诚整理

跟踪期内，公司通过精准识别、定制化服务和持续关系维护，提升客户满意度与忠诚度，同时积极拓展汽车电子、清洁能源、储能、安防、5G 通讯、物联网、人工智能等新兴市场，主要客户较为稳定

公司涉及内销和外销销售。内销采用直销为主、经销为辅的营销模式。外销主要销往台湾、欧洲、韩国等地区，以直销模式为主，2024 年，公司外销收入占公司半导体元器件销售收入的比重为 24.70%，同比下降 4.78 个百分点。在销售回款方面，部分客户会收取预收款，部分客户款到发货，一般会给予 30~90 天不等的账期。

跟踪期内，公司通过精准识别、定制化服务和持续关系维护，提升客户满意度与忠诚度；并以市场需求为导向，优化产品规划与定位，进一步丰富功率器件产品种类；公司在保持和提升在传统领域的优势的同时，紧跟市场方向，积极拓展汽车电子、清洁能源、储能、安防、5G 通讯、物联网、人工智能等新兴市场，全力推进替代进口战略，加快渗透，扩大对下游优质客户的覆盖。2024 年，公司主要客户较为稳定，前五名客户销售额合计占年度销售总额比例 24.68%，同比有所下降。

图表 7：2024 年公司前五大客户销售情况³（亿元、%）

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例
1	单位 1	0.89	9.81
2	单位 2	0.42	4.62
3	单位 3	0.32	3.57
4	单位 4	0.31	3.41
5	单位 5	0.30	3.27
合计		2.24	24.68

资料来源：公司提供、东方金诚整理

公司仍采用集中管理、分散采购的模式，采购原材料以芯片为主，跟踪期内，芯片采购均价有所下降，框架/引线、铜材等采购均价有所上涨，主要供应商变化不大

跟踪期内，材料成本占营业成本比重仍在 60%以上，主要原材料仍为芯片、框架/引线、铜材、塑封料、包装材料、化工材料、硅片等，其中芯片占比最大。采购价格方面，芯片采购均价有所下降，框架/引线、铜材等的采购均价有所增加。公司仍采用“集中管理、分散采购”的模式，公司统一进行合格供应商管理，每年统一与供应商签订采购框架协议、质保协议等，各产品事业部根据生产计划需求及原材料库存进行采购，采购款一般按月结算，结算后有 60~90 天不等的账期。

跟踪期内，公司主要供应商变动不大，前五大供应商采购金额合计占采购总金额的比重为 25.22%，采购整体仍较为分散。

³ 为公司全部业务的前五大客户。

图表 8：2024 年公司前五大供应商⁴（亿元、%）

序号	供应商名称	采购内容	采购金额	占比
1	单位 1	框架/引线	0.49	9.64
2	单位 2	芯片	0.30	6.04
3	单位 3	芯片	0.17	3.46
4	单位 4	框架/引线	0.16	3.17
5	单位 5	芯片	0.15	2.91
合 计			1.27	25.22

资料来源：公司提供、东方金诚整理

未来发展

公司在建项目为车规级半导体器件产业化项目，国产替代趋势下有助于公司产品升级及业务规模扩大，但后续投资规模较大，若市场开拓不及预期、外部经济环境等方面发生较大不利变化，或面临一定产能消纳及投资回报不及预期的风险

截至 2024 年末，公司主要在建项目预计总投资 5.40 亿元，累计已投入 1.90 亿元，尚需投入 3.50 亿元，为“银微转债”募投项目⁵。

车规级半导体器件产业化项目通过购置先进的芯片制造设备、封测设备及车规级半导体分立器件试验和检测设备，引进专业的研发生产人员，建设涵盖芯片设计、制造和封装测试全流程的车规级半导体分立器件生产线，强化公司车规级半导体分立器件的一体化生产能力，提升公司高端半导体分立器件的产能规模，达产期 5 年，项目完全达产后年均销售收入为 4.06⁶亿元，年均净利润约 0.60 亿元。

未来在建项目完工投产后，公司生产能力将进一步增加，国产替代趋势下有助于业务规模提升，但在建项目未来投资规模仍较大，如果在项目实施过程中产品研发、市场开拓、外部经济环境等方面发生较大不利变化，则项目是否能够按时实施、生产产品最终能否成功获得市场认可、项目实施效果是否符合预期、项目预计效益能否实现等将存在不确定性。

图表 9：截至 2024 年末主要在建项目（亿元）

项目名称	总投资	已投资	仍需投资
车规级半导体器件产业化项目	5.40	1.90	3.50
合计	5.40	1.90	3.50

资料来源：公司提供、东方金诚整理

公司治理与战略

跟踪期内，公司在内部治理、发展战略方面无重大变化

公司治理方面，跟踪期内，公司董事、监事、高管人员无重大变化，组织结构方面无重大

⁴ 为公司全部业务的前五大供应商。

⁵ 2024 年 6 月 28 日，公司发布《常州银河世纪微电子股份有限公司关于可转债募投项目延期的公告》，将“车规级半导体器件产业化项目”预定可使用状态日期由“2024 年 7 月”调整为“2026 年 7 月”。

⁶ 数据来源：《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

变化。

公司战略方面，公司将继续实施技术创新，专注于半导体分立器件行业做精做强，进一步拓宽产品种类，提升产品性能，提高产品档次；公司将继续推进结构调整，坚持纵向一体化发展战略，全面优化芯片和封测技术，增强生产柔性和效率，扩大经营规模；公司将继续坚持市场导向，提升市场营销能力，强化技术服务支撑，拓展国内外中高端市场领域，提升盈利能力。

公司秉承低碳经营的可持续发展理念，积极推行 ISO50001、ISO14064、ISO14067、ISO45001 等国际化标准管理体系，倡导绿色经营。通过导入太阳能光伏电站、无纸化智能办公系统、苏文电力控制系统、废水回收利用系统、余热回收利用系统、高密度矩阵式框架生产技术等管理改进和技术革新方案，努力减少有毒有害物质排放，降低工业废弃物产生，提高清洁能源使用占比，提升资源利用效率，以实现可持续发展的战略目标。2024 年，公司荣获“国家级绿色工厂”“常州市智能工厂”“常州市创建和谐劳动关系先进企业”“常州市明星企业”等荣誉称号。

财务分析

财务质量

公司提供了 2024 年审计报告及 2025 年 1~3 月财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务数据进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，2025 年 1~3 月财务报表未经审计。截至 2024 年末，公司纳入合并范围的子公司共 7 家，较上年末新增 2 家子公司，分别为常州银河光电科技有限公司、常州银芯微功率半导体有限公司。

资产构成与质量

跟踪期内，公司资产结构变动不大，随着业务规模增加，应收账款、存货规模有所增长

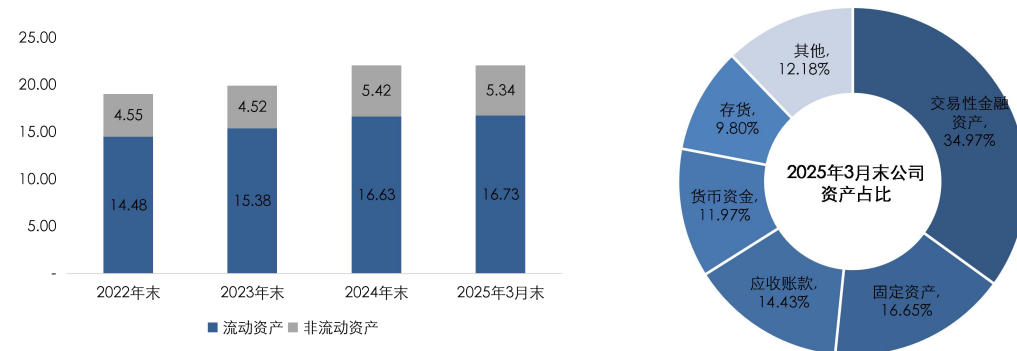
跟踪期内，公司资产规模有所增长，资产结构仍以流动资产为主。

跟踪期内，公司流动资产规模有所增长，截至 2025 年 3 月末为 16.73 亿元，仍主要由交易性金融资产、应收账款、货币资金和存货等构成。交易性金融资产是公司购买的银行理财产品，跟踪期内规模小幅波动。受销售增加及结算周期影响，跟踪期内应收账款规模有所增长，周转效率有所加快，2024 年末按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产期末余额合计占比 31.84%。跟踪期内货币资金规模有所减少，截至 2024 年末，公司无受限货币资金。公司存货主要为在产品、发出商品和原材料，跟踪期内随着业务规模增加，存货规模有所增长，且周转效率有所加快；截至 2024 年末，累计计提存货跌价准备 0.18 亿元，计提比例 8.35%。

随着在建工程的购建及长期股权投资增加，跟踪期内，非流动资产规模增长。截至 2025 年 3 月末，主要由固定资产、在建工程和长期股权投资等构成。由于折旧，跟踪期内固定资产规模有所减少。跟踪期内，由于车规级半导体器件产业化项目持续投入以及部分设备投入，在建工程规模保持增长。跟踪期内，由于新增对上海澜芯半导体有限公司 0.30 亿元投资，长期股权投资规模增长，截至 2024 年末，公司对外投资的联营企业 2 家，分别为上海优曜半导体科技有限公司和上海澜芯半导体有限公司。

截至 2024 年末，公司受限资产规模为 1769.46 万元；其中受限应收票据 1738.19 万元，受限原因为“已背书或贴现未到期的应收票据未终止确认”；受限应收账款 29.70 万元，受限原因为“已背书或贴现未到期的数字债权凭证未终止确认”；合计占资产总额比重为 0.80%，占净资产比重为 1.29%。

图表 10：公司资产构成及质量情况（亿元）



项目	2022 年末	2023 年末	2024 年末	2025 年 3 月末
交易性金融资产	7.70	7.54	7.92	7.72
应收账款	2.07	2.23	3.35	3.18
货币资金	2.72	2.80	2.47	2.64
存货	1.58	1.65	1.95	2.16
流动资产合计	14.48	15.38	16.63	16.73
固定资产	3.65	3.75	3.74	3.67
在建工程	0.24	0.16	0.75	0.76
长期股权投资	0.06	0.06	0.32	0.31
其他权益工具投资	0.25	0.25	0.25	0.25
非流动资产合计	4.55	4.52	5.42	5.34
资产总额	19.04	19.90	22.06	22.08

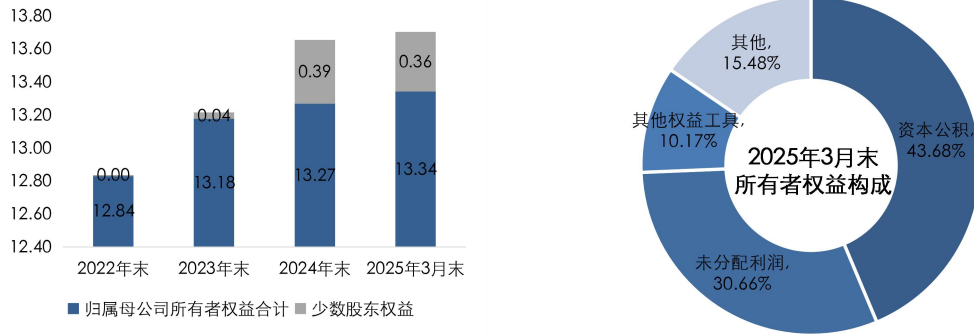
资料来源：公司提供，东方金诚整理

资本结构

受益于经营积累及少数股东权益增加，跟踪期内公司所有者权益保持增长，资本公积和未分配利润占比仍较高

受益于经营积累及吸收少数股东投资，跟踪期内所有者权益规模保持增长，主要由资本公积、未分配利润、其他权益工具、股本和少数股东权益等构成。跟踪期内，由于股权回购，资本公积有所减少；受益于经营积累，未分配利润保持增长；其他权益工具和股本变化不大；少数股东权益增幅较大。

图表 11：公司所有者权益情况（亿元）



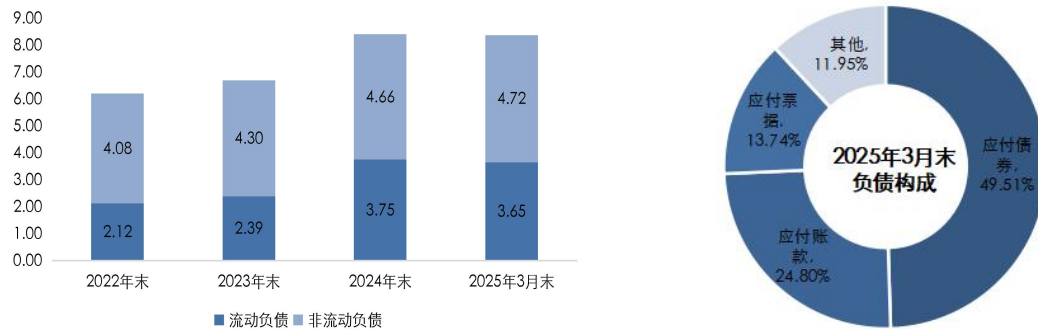
资料来源：公司提供，东方金诚整理

跟踪期内，公司债务规模有所增长，债务构成以存续债券“银微转债”为主

跟踪期内，由于应付账款、应付票据等增加，负债总额增幅较大，仍主要由非流动负债构成。

截至 2025 年 3 月末，公司流动负债为 3.65 亿元，跟踪期内增幅较大，仍主要由应付账款和应付票据等构成。2024 年末，由于原料采购增加，应付账款及应付票据规模均同比增幅较大，其中账龄 1 年以内（含 1 年）应付账款的占比 97.93%。跟踪期内，非流动负债仍主要由应付债券等构成，由于“银微转债”按面值计提利息及溢折价摊销，应付债券规模有所增长，带动非流动负债规模增长。

图表 12：公司负债情况（亿元）



项目	2022 年末	2023 年末	2024 年末	2025 年 3 月末
应付账款	1.23	1.57	2.45	2.08
应付票据	0.65	0.52	0.85	1.15
流动负债合计	2.12	2.39	3.75	3.65
应付债券	3.42	3.73	4.05	4.14
非流动负债合计	4.08	4.30	4.66	4.72
负债总额	6.20	6.69	8.40	8.37

资料来源：公司提供，东方金诚整理

跟踪期内，由于“银微转债”按面值计提利息及溢折价摊销应付债券规模增长以及应付票据规模增加，公司全部债务规模增幅较大，截至2025年3月末，公司全部债务5.38亿元，包括“银微转债”、应付票据和租赁负债，其中短期债务和长期债务占比分别为22.85%和77.15%。跟踪期内，公司资产负债率、长期债务资本化比率、全部债务资本化比率均有所增长。

对外担保方面，截至2025年3月末，公司无对外担保。

图表 13：公司债务情况（亿元）



资料来源：公司提供，东方金诚整理

盈利能力

2024年，行业温和复苏，公司整体产销提升，营业收入同比增长，盈利能力有所提升

2024年，行业温和复苏，公司整体产销提升，全年实现营业收入9.09亿元，同比增加30.75%；同期，营业利润率25.62%，同比变化不大。2024年，随着业务规模扩大、研发投入增加、利息费用增多，期间费用规模有所扩大，但期间费用率有所下降。

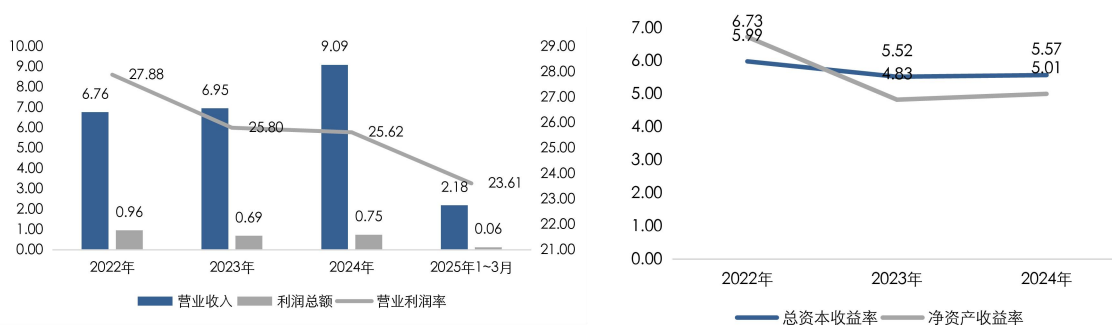
2024年，公司非经营性收益主要是其他收益与公允价值变动收益，非经营性损失主要是资产减值损失；由于进项税加计抵减增加，其他收益同比增加；公允价值变动损益仍为交易性金融资产公允价值变动产生，同比减少4.15%；由于存货跌价损失及合同履约成本减值损失计提规模增加，资产减值损失同比多损失0.04亿元。整体来看，2024年公司非经营性损益规模合计⁷0.08亿元，对利润总额影响不大。

由于主营业务获利规模增加，2024年公司实现利润总额0.75亿元，同比增加8.28%。同期，公司总资本收益率和净资产收益率均同比增加，整体盈利能力有所提升。

2025年1~3月，公司实现营业收入2.18亿元，同比增加12.11%；营业利润率23.61%，同比下降3.12个百分点；利润总额0.06亿元，同比下降68.14%。

⁷ 包括其他收益、投资收益、公允价值变动损益、信用减值损失、资产减值损失、资产处置收益、营业外收入和营业外支出。

图表 14：公司盈利能力情况（亿元、%）



资料来源：公司提供，东方金诚整理

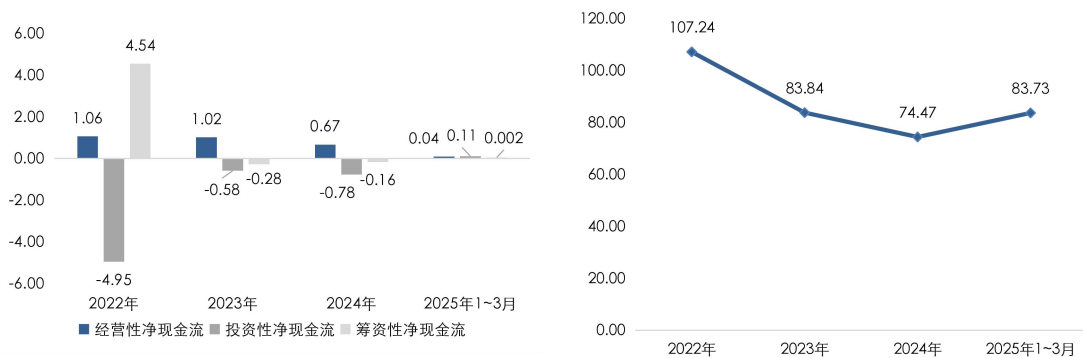
现金流

跟踪期内，应收账款及存货对资金占用增加，经营性现金净流入规模同比降幅较大，投资活动现金流持续净流出，筹资活动产生的现金流规模不大

2024年，由于应收账款及存货对资金占用增加，公司净利润增长但经营性现金流净流入规模同比降幅较大。同期，现金收入比为74.47%，同比有所下降。

公司投资活动现金流入主要为收回的理财产品投资资金；投资活动现金流出主要为购买理财产品支出资金以及购建固定资产等支付的现金；跟踪期内，受购建固定资产支出影响，投资活动现金流持续净流出。筹资活动方面，2024年，公司筹资活动产生的现金流入、流出规模均较小。

图表 15：公司现金流及现金收入比情况（亿元、%）



资料来源：公司提供，东方金诚整理

偿债能力

从短期偿债能力指标来看，跟踪期内，公司流动比率和速动比率均有所下降，经营性净现金流对流动负债的覆盖程度有所减弱，EBITDA对利息的覆盖程度有所提升，对全部债务的覆盖程度有所下降。

截至2025年3月末，公司短期债务为1.23亿元；截至本报告出具日，公司无未来一年到期的债券（含回售）。2024年公司经营性净现金流为0.67亿元，投资性净现金流为-0.78亿元，筹资活动前净现金流为-0.11亿元。预计2025年，随着新能源汽车、5G通信、工业自动化等

新兴领域的需求增长及国产化替代加速，公司小信号器件、功率器件需求空间仍较为广阔，将带动公司产品销售规模增长，“车规级半导体器件产业化项目”仍将保持一定规模的资本支出，预计筹资活动前净现金流仍为净流出。

公司融资渠道畅通，截至 2025 年 3 月末，公司合并口径的银行授信总额 4.88 亿元，未使用额度 3.68 亿元，具有一定备用流动性。

图表 16：公司偿债能力主要指标（%、倍）

指标名称	2022 年（末）	2023 年（末）	2024 年（末）	2025 年 3 月（末）
流动比率	681.89	644.76	443.90	458.69
速动比率	607.46	575.39	391.84	399.37
经营现金流流动负债比	50.02	42.61	17.89	-
EBITDA 利息倍数	10.35	4.73	4.83	-
全部债务/EBITDA	2.62	2.76	2.90	-

资料来源：公司提供，东方金诚整理

过往期债务履约和其他信用记录

根据公司提供的、由中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》（自主查询版），截至 2025 年 5 月 29 日，公司本部未结清贷款中不存在关注及不良类记录。

截至本报告出具日，“银微转债”按时支付利息，尚未到还本日。

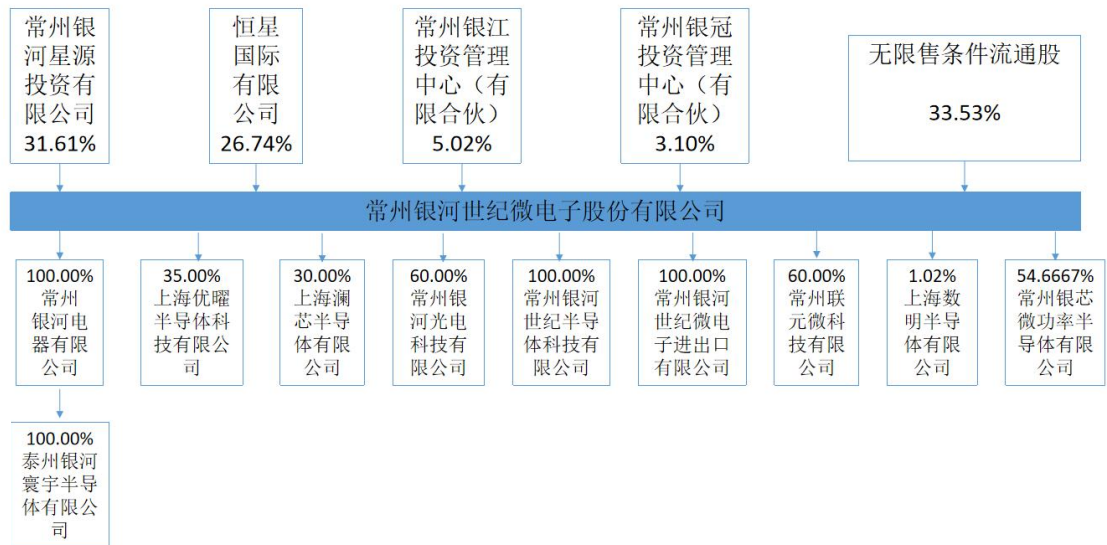
抗风险能力及结论

公司主要从事半导体分立器件研发、生产和销售，具备多门类系列化器件设计、部分品种芯片制造、多工艺封装测试以及销售和服务的一体化经营能力，跟踪期内仍具有一定细分市场竞争力；跟踪期内，公司围绕芯片设计迭代、新封装开发、产品质量改善、集成器件开发等进行研发，研发费用 0.56 亿元，同比增加 33.08%，获得发明专利 10 项，有助于未来业务发展；跟踪期内，公司持续推进新产品布局，车规级半导体器件产业化项目进入产能爬坡阶段，产品涵盖 IGBT、SiC MOSFET 等，获得多家车企供应链认证，同时光电耦合器及 LED 产品实现工业自动化、医疗设备等领域应用；2024 年，下游市场温和复苏，公司积极调整产品结构、加大客户拓展力度，小信号器件、功率器件销量同比增长，带动营业收入及毛利润增长。

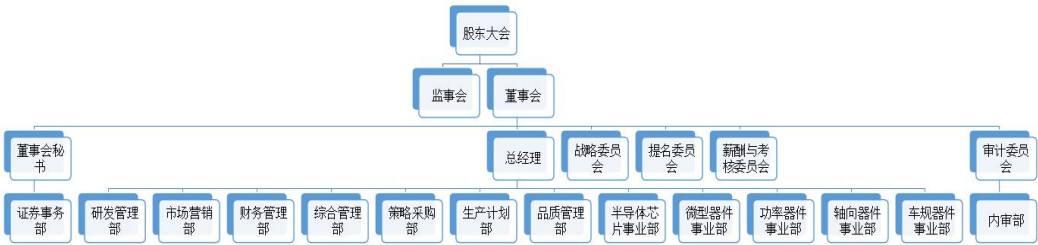
但同时，东方金诚关注到，半导体分立器件领域技术更迭较快，下游客户需求不断升级、行业产品迭代仍将使公司面临技术升级挑战；2024 年，应收账款及存货对资金占用增加，经营性现金流净流入规模有所下降；2024 年末，公司在建项目后续投资规模仍较大，外部环境变化或将使公司面临投资回报不及预期的风险。

综合分析，东方金诚维持银河微电主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，维持“银微转债”的信用等级为 A+。

附件一：截至 2025 年 3 月末公司股权结构图



附件二：截至 2025 年 3 月末公司组织结构图



附件三：银河微电主要财务数据和财务指标

项目名称	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 3 月
主要财务数据及指标				
资产总额（亿元）	19.04	19.90	22.06	22.08
所有者权益（亿元）	12.84	13.21	13.65	13.70
负债总额（亿元）	6.20	6.69	8.40	8.37
短期债务（亿元）	0.67	0.54	0.93	1.23
长期债务（亿元）	3.46	3.75	4.06	4.15
全部债务（亿元）	4.13	4.29	4.99	5.38
营业收入（亿元）	6.76	6.95	9.09	2.18
利润总额（亿元）	0.96	0.69	0.75	0.06
净利润（亿元）	0.86	0.64	0.68	0.04
EBITDA（亿元）	1.58	1.55	1.72	0.15
经营活动产生的现金流量净额（亿元）	1.06	1.02	0.67	0.04
投资活动产生的现金流量净额（亿元）	-4.95	-0.58	-0.78	0.11
筹资活动产生的现金流量净额（亿元）	4.54	-0.28	-0.16	0.00
毛利率（%）	28.36	26.49	26.22	23.99
营业利润率（%）	27.88	25.80	25.62	23.61
销售净利率（%）	12.78	9.18	7.52	1.68
总资本收益率（%）	5.99	5.52	5.57	-
净资产收益率（%）	6.73	4.83	5.01	-
总资产收益率（%）	4.54	3.21	3.10	-
资产负债率（%）	32.57	33.60	38.10	37.92
长期债务资本化比率（%）	21.23	22.10	22.93	23.26
全部债务资本化比率（%）	24.34	24.49	26.76	28.21
货币资金/短期债务（%）	405.99	520.48	266.43	214.86
非筹资性现金净流量债务比率（%）	-94.14	10.12	-2.15	2.91
流动比率（%）	681.89	644.76	443.90	458.69
速动比率（%）	607.46	575.39	391.84	399.37
经营现金流动负债比（%）	50.02	42.61	17.89	-
EBITDA 利息倍数（倍）	10.35	4.73	4.83	-
全部债务/EBITDA（倍）	2.62	2.76	2.90	-
应收账款周转率（次）		3.24	3.26	-
销售债权周转率（次）		2.97	2.99	-
存货周转率（次）		3.16	3.72	-
总资产周转率（次）		0.36	0.43	-
现金收入比（%）	107.24	83.84	74.47	83.73

附件四：主要财务指标计算公式

指标	计算公式
毛利率 (%)	$(\text{营业收入} - \text{营业成本}) / \text{营业收入} \times 100\%$
营业利润率 (%)	$(\text{营业收入} - \text{营业成本} - \text{税金及附加}) / \text{营业收入} \times 100\%$
销售净利率 (%)	$\text{净利润} / \text{营业收入} \times 100\%$
净资产收益率 (%)	$\text{净利润} / \text{所有者权益} \times 100\%$
总资本收益率 (%)	$(\text{净利润} + \text{利息费用}) / (\text{所有者权益} + \text{长期债务} + \text{短期债务}) \times 100\%$
总资产收益率 (%)	$\text{净利润} / \text{资产总额} \times 100\%$
资产负债率 (%)	$\text{负债总额} / \text{资产总额} \times 100\%$
长期债务资本化比率 (%)	$\text{长期债务} / (\text{长期债务} + \text{所有者权益}) \times 100\%$
全部债务资本化比率 (%)	$\text{全部债务} / (\text{长期债务} + \text{短期债务} + \text{所有者权益}) \times 100\%$
担保比率 (%)	$\text{担保余额} / \text{所有者权益} \times 100\%$
EBITDA 利息倍数 (倍)	$\text{EBITDA} / \text{利息支出}$
全部债务/EBITDA (倍)	$\text{全部债务} / \text{EBITDA}$
货币资金/短期债务 (倍)	$\text{货币资金} / \text{短期债务}$
非筹资性现金净流量债务比率 (%)	$(\text{经营活动产生的现金流量净额} + \text{投资活动产生的现金流量净额}) / \text{全部债务} \times 100\%$
流动比率 (%)	$\text{流动资产合计} / \text{流动负债合计} \times 100\%$
速动比率 (%)	$(\text{流动资产合计} - \text{存货}) / \text{流动负债合计} \times 100\%$
经营现金流动负债比率 (%)	$\text{经营活动产生的现金流量净额} / \text{流动负债合计} \times 100\%$
应收账款周转率 (次)	$\text{营业收入} / \text{平均应收账款净额}$
销售债权周转率 (次)	$\text{营业收入} / (\text{平均应收账款净额} + \text{平均应收票据})$
存货周转率 (次)	$\text{营业成本} / \text{平均存货净额}$
总资产周转率 (次)	$\text{营业收入} / \text{平均资产总额}$
现金收入比率 (%)	$\text{销售商品、提供劳务收到的现金} / \text{营业收入} \times 100\%$

注：EBITDA=利润总额+利息费用+折旧+摊销

长期债务=长期借款+应付债券+租赁负债+其他长期债务

短期债务=短期借款+交易性金融负债+一年内到期的非流动负债+应付票据+其他短期债务

全部债务=长期债务+短期债务

利息支出=利息费用+资本化利息支出

附件五：企业主体及中长期债券信用等级符号及定义

等级	定义
AAA	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
AA	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
A	偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低
BBB	偿还债务能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般
BB	偿还债务能力较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险
B	偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高
CCC	偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高
CC	在破产或重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务
C	不能偿还债务

注：除 AAA 级和 CCC 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

短期债券信用等级符号及定义

等级	定义
A-1	还本付息能力最强，安全性最高
A-2	还本付息能力较强，安全性较高
A-3	还本付息能力一般，安全性易受不良环境变化的影响
B	还本付息能力较低，有一定的违约风险
C	还本付息能力很低，违约风险较高
D	不能按期还本付息

注：每一个信用等级均不进行微调。